

BOLIX ZP



Piana do przyklejania styropianu

CECHY PRODUKTU:

- wydajność z jednej puszkii:
 - do 8 m² w trakcie montażu płyt styropianowych do podłoża ściennych
 - do 12 m² przy klejeniu płyt EPS lub XPS przy ocieplaniu fundamentów i podziemnych części budowli
- niskoprężny
- kołkowanie już po 2h
- możliwość prowadzenie prac przy temperaturze $\geq 0^{\circ}\text{C}$
- doskonała przyczepność do podłoża mineralnych i płyt styropianowych EPS, w tym grafitowych oraz XPS
- bardzo dobra termoizolacyjność

PRZEZNACZENIE:

BOLIX ZP to niskoprężny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy do przyklejania płyt styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych, a także do mocowania drugiej warstwy ocieplenia na ścianach już ocieplonych. Dedykowany również do ocieplania stref przyziemia i fundamentów płytami EPS-P oraz XPS.

Służy do:

- montażu:
 - płyt styropianowych EPS i XPS,
 - kasetonów styropianowych,
 - parapetów zewnętrznych,
- wypełniania szczelin w izolacji termicznej i dylatacjach pionowych w murach,
- sklejania płyt styropianowych,
- Mocowania kolejnych płyt styropianowych EPS na istniejącym ociepleniu opartym na płytach styropianowych EPS – „ocieplenia na ocieplenia”

Może być stosowany na podłożach:

- mineralnych (takich jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, itp.),
- drewnianych i drewnopochodnych tj płyty OSB, sklejka, wiórowe, wiórowo-cementowe etc,
- z twardego PCV, poliestru, poliuretanu, itp.
- hydroizolacjach asfaltowych i bitumicznych.
- Stal, aluminium i inne metale

W przypadku podłoża bitumicznych i tworzyw sztucznych zaleca się przeprowadzić test przyczepności.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być: nośne, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, glony, mchy i innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku klejenia płyt styropianowych w niskich temperaturach z podłoża należy usunąć szron i oblodzenia. Podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Większe nierówności i ubytki wyrównać zaprawą BOLIX W lub BOLIX WB (podłoża betonowe).

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach lub podłożach o nieznanymi właściwościami, należy wykonać próbę przyczepności. Należy przykleić w kilku miejscach na elewacji próbki styropianu o wym. 10x10x5 cm i ręcznym ich odrywaniu po min. 2 – 4 godzinach. Nośność podłoża jest wystarczająca, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W innym przypadku podłoże należy dostosować np. poprzez szlifowanie, usuwanie osłabionych warstw, gruntowanie i ponowne wykonanie próby przyczepności.

Podczas klejenia płyt styropianowych do podłoża ściennych należy zamocować listwy startowe, a w systemach izolacji fundamentów w celu uzyskania stabilnego podparcia dla klejonych płyt termoizolacyjnych, należy je wesprzeć na stopie fundamentowej, (jeśli to możliwe podeprzeć je w trakcie wiązania).

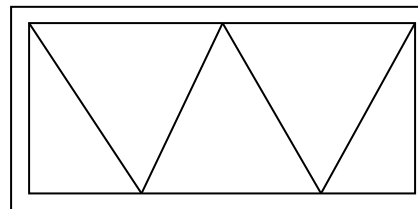
Przed ociepleniem budynków wielopłytowych zaleca się przeprowadzenie oceny stanu mocowania płyt fakturowych.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Puszka powinna mieć temperaturę dodatnią (optymalna +20°C). Pojemnik przez ok. 30 sekund intensywnie potrząsać, a następnie nakręcić do pistoletu aplikacyjnego (Uwaga! Zawór pistoletu powinien być zakręcony). Po przykręceniu otworzyć zawór i dozować w pozycji roboczej "do góry dnem" przez naciśnięcie spustu. Regulację strumienia dokonać poprzez ustawienie iglicy lub nacisk spustu pistoletu aplikacyjnego. W przypadku przerwy w nakładaniu powyżej 15 minut, pistolet aplikacyjny należy zabezpieczyć, pozostawiając nakręconą puszkę do kolejnego użycia.

ZASTOSOWANIE:

W przypadku klejenia płyt EPS i XPS powyżej fundamentów, piankę należy nakładać na płytę styropianową warkoczem, po obwodzie płyty z zachowaniem dystansu 2 cm od krawędzi oraz pasmem w kształcie litery M lub W.



Podczas klejenia płyt termoizolacyjnych do powierzchni fundamentów i podziemnych części budynków / budowli pokrytych hydroizolacją asfaltową lub bitumiczną, klej poliuretanowy należy nakładać na płytę przy użyciu pistoletu czterema pionowymi pasmami z zachowaniem równych odstępów co $20 \div 30$ cm i zachowaniem dystansu 3 cm od



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX ZP

Piana do przyklejania styropianu

krawędzi płyty. (w przypadku płyt o szerokości powyżej 100 cm, należy nałożyć na powierzchnię płyty większą ilość warkoczy kleju).



Po nałożeniu kleju w obu przypadkach w ciągu maksymalnie 10 minut płyty należy przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć łąką aż do uzyskania równej powierzchni z płytami wcześniej przyklejonymi. Nie przekraczać czasu naskórkowania! Możliwa jest korekta położenia płyty względem podłoża w czasie do 25 min (w zależności od warunków) od jej przyklejenia.

Po upływie około 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki (szlifowanie i kołkowanie). Płyty termoizolacyjne powyżej fundamentów należy obowiązkowo mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych, zgodnie z projektem technicznym ocieplenia.

Przy fundamentach oraz obszarach podziemnych kołkowanie termoizolacji należy zaniechać aby nie uszkodzić hydroizolacji.

Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Szczeliny między płytami na całej grubości ocieplenia należy wypełnić styropianem lub niskoprężną pianką poliuretanową BOLIX PM-L lub BOLIX ZP.

Styropian przyklejając z zachowaniem mijankowego układu płyt.

Dla zwiększenia przyczepności, przyspieszenia utwardzenia i poprawy struktury, podłoże można wstępnie zwilżyć za pomocą rozpylacza.

Spoina klejowa uzyskuje pełną wytrzymałość po 24h od przyklejenia płyt.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Przed przystąpieniem do prac, elementy takie jak okna, drzwi, parapety należy odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować minimum 28 dni.
- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do ocieplenia uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.
- Przed przyklejeniem termoizolacji należy zidentyfikować wszystkie instalacje biegnące po elewacji lub w jej pobliżu, aby nie uszkodzić ich podczas mocowania mechanicznego ociepleń (wiercenie otworów).
- W czasie nakładania i dojrzewania pianki, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.
- Wskutek oddziaływania promieni słonecznych styropian grafitowy ulega szybkiemu nagrzewaniu, co może spowodować odkształcenia i/lub deformację płyt styropianowych. Dlatego też zaleca się zastosowanie emulsji BOLIX PTE ograniczającej absorpcję promieniowania cieplnego przez materiał termoizolacyjny, tym samym znacznie ograniczając jego odkształcenia termiczne.
- Niska temperatura, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania i dojrzewania pianki klejącej.
- Wysoka wilgotność powietrza i podłoża powoduje przyspieszenie wiązania pianki poliuretanowej.

- Pianka nie przylega do silikonu, teflonu, polietylenu, polipropylenu i poliamidu.
- Nie stosować na podłożach bitumicznych i asfaltowych na bazie rozpuszczalników organicznych.
- Po zakończeniu prac pistolet aplikacyjny przeczyszczyć. Zaleca się stosowanie czyścika do pian poliuretanowych BOLIX CP lub acetonem, stwardniały klej usunąć mechanicznie.
- Miejsca, w których klej jest wyeksponowany na działanie UV należy zabezpieczyć
- W termoizolacji podziemnych części budynków klej można stosować wyłącznie w systemach hydroizolacji przeciwwilgociowej
- Nie stosować w przypadku ciągłej ekspozycji na wodę, np. zanurzenie spowodowane wysokim poziomem wód gruntowych np. hydroizolacja przeciwwodna ciężka.
- Płyty termoizolacyjne można kleić po całkowitym wyschnięciu powłok hydroizolacyjnych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I PRZECHOWYWANIE:

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej (aby zapobiec zaklejaniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5 do +25 °C (zalecana temperatura pokojowa) chroniąc od bezpośredniego nasłonecznienia lub innych źródeł ciepła i zapłonu.

Temperatura w czasie transportu nie powinna spadać poniżej +5 °C, chociaż ze względu na bezwładność temperaturową dopuszcza się kilkunastogodzinny przewóz w temperaturze ujemnej do -15 °C

Wyrób zawiera izocyjany. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją dostarczoną przez producenta, warunkami bezpiecznego stosowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i niniejszej karcie technicznej. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem

i nagrzaniem powyżej temperatury +50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu -nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi. Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią. Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcję alergiczne u osób uczulonych na diizocyjany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórno-skórnego. Produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387). Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Pistolet do pianki

DANE TECHNICZNE:

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i dojrzewania:

od 0°C do +35°C

Ciężar właściwy wg ISO 7390

20 - 25 kg/m³

Barwa:

szara

Formuła:

Niskoprężna

Masz pytania?
 Zadzwoń!
 801-650-222
 Napisz!
 serwis@bolix.pl

BOLIX SA
 Ul. Stolarska 8
 34-300 Żywiec
 Tel. 33 475 06 00
 Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX ZP

Piana do przyklejania styropianu

Struktura:

jednorodna, drobnokomórkowa

Czas naskórkowania:

ok 10 min. *

Czas dojrzewania przed dalszą obróbką:

≥ 2h (temp. +20°C i 50% wilgotności względnej powietrza)

Czas pełnego utwardzenia:

do 24h (pełna obciążalność mechaniczna) *

Wsp. przewodzenia ciepła:

≤ 0,0348 W/(m*K)

Odporność termiczna po utwardzeniu:

-40°C ÷ +90°C (krótkotrwanie do +140 °C)

Stabilność wymiarów:

-5%

Klasa palności wg normy DIN 4102-1:

B3

Rozpuszczalność preparatu:

przed utwardzeniem ulega rozpuszczeniu w rozpuszczalnikach organicznych tj. aceton

Przyczepność do betonu, MPa:

≥ 0,3

Przyczepność do styropianu MPa:

≥ 0,1 (zerwanie w masie)

Opakowania:

puszka 750 ml

Ilość opakowań w kartonie i waga netto produktu:

12

Okres przydatności do stosowania:

18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

*Silna zależność od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza oraz podłoża, temperatury puszk, sposobu zastosowania, przekroju nałożonej warstwy, zwilżenia podłoża itp.

ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ OPAKOWANIA:

- ocieplenia powyżej fundamentów – **do 8 m²**
- ocieplenia fundamentów i przyziemia – **do 12 m²**

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

SKŁAD:

Dizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu, gaz pędny mieszanina skroplona pod ciśnieniem zawierająca propan-butan-izobutan

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

**Masz pytania?**Zadzwoń!
801-650-222Napisz!
serwis@bolix.pl**BOLIX SA**Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12**Znajdź nas**www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl**BOLIX®**